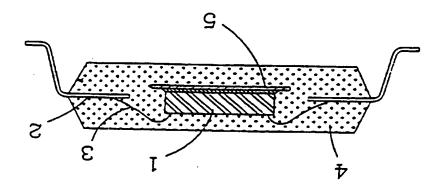
BEST AVAILABLE COPY

(18) 주운(원 등 등 등 (81)

	<u></u>	世紀知 四引入의 初조방법	유공룡 (79)
		무선 : 유학용	<u> 두병사삼 (۲۲)</u>
		H인자	(74) CHSIS
	5)1도 성남시 로션는 수내용 22 美데이미트 132-1504		
		대략하	
		숙용동	八四盟 (27)
	서롱널롭게 워운스 워수운 2가 280-8		
		133-151	
	·	대화하물	
•		병류남 , 사례수주때교병님(0	(57) 를 (27)
高Z0層 U 函Z66 L	댓울K(용 (84)	高10層和39661	(SS) 출유공(
三 1667-0072358	호유K은 (99)	D116000-9661-01	호면명출 (12)
1999년(661	(24) 容量引力		
10-0550124	(11) 용복원호		H01F 53/20
7.0860 3661	仅度正各 (54)		(51) Int. Cl.

, 디IOI지(EMIK고면 국었 수 옆 현소본 울校면정삼 사회으염 혼고추 울물정호상 사IN연당 [부근] N 정상 M 고보인데 변시출과 회부의 융명자 C 현민은 물띤호 인출병명 공단방병 시주공로면 변시출고 모부면 울면지 면섭대고면 '로요섯 형ਓ 10조두 및 범방조대 인지(6페라고면 음양병 목 ಕ್ಷಾ

玉玉的



[류유리 유원] SAIK

望锡圣城 阿太尼斯城是增

[논급히 하단한 학명]

고현당 양보 홍조두 의지(5때나고방 양주병을 걸고 1 때

제 2 도는 본 발명에 작용되는 라드프레임을 도시한 평면도

지 3s 도 대지 제 3e 도는 본 발명의 제조 5C 대

고성은 조ዚ 년만 110세이스을 만명할 꼭 크고 나에 다 내고 요수 11

コミ江岸: 27

고면자 연지(문교법교업 현일 10명별 꼭 글고 3 IX

. 제 6 포는 돈 함영히 이름을 포시한 하대포

• 도면의 주요무분에 대한 부호의 성명

20: 의도프레임 10: 型도划型

Ю1015:08 고요: 12

版[[등 학생 등 기계

2002/10/10

. 병명조대 인치(6.11) 교육 로스 로스 등을 받고 반당을 밝혀 다음 10명

제 1 함에 있어서, 상기 동당명역의 외각에 위치한 리드를 잘단하는 단계는, 상기 리드의 잘단되는 부위에 노치(Noich)를 형성하여 상기리드기 작구함 3.

. 엄명조ඟ 인지(대때대고면 크려 코오징후 울섯 전(0후(0) 사회생명포 년 등

公存下多 (Grind)를 생겨하는 당한 물 (Aring)를 받는 (Grind)를 받는 사용 (Grind)를 받는 사용 (Hash)를 제어 (Figsh)를 제어 되었다. 하는 물 기술 (M 등 대한 기술 (M)을 (M

. 智智圣队 但以后把以足罗

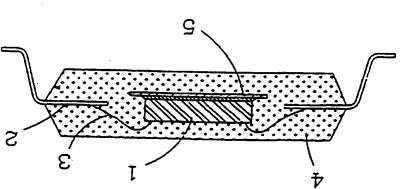
다 보호하기 위하여 동안하는 단계와; 상기 단계후에 동안망면 외관에 위치한 인도를 참단하는 단계를 보험하여 이후에진 것을 확인으로 하는 반도체함을 되지시키되, 상기 반도체함은 배를 출(VacuumHole)이 형성된 리드, 번도체함 및 와이어를 외부의 산회 및 부식으로 부양적에 반도체함을 위치시키되, 상기 반도체함은 배를 출(VacuumHole)이 형성된 히디드, 번도체함 및 와이어를 외국에 안을 공기를 받이들여서 양적에 반도체함을 위치시키되, 상기 반도체함은 배를 출(VacuumHole)이 향성된 히디드 인보하는 단계와 및 상기 대도계합의 다수의 인도중(경정) 다수의 인도가 형성되고, 이 다수의 인도 중앙부에는 합량재판이 있는 인도프레인을 제공하는 단계와; 상기 인도프레임의 다수의 인도중정구령 1.

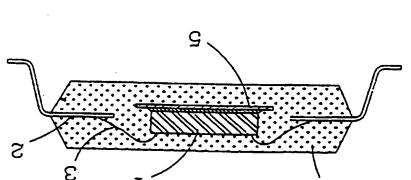
유명 (YS)

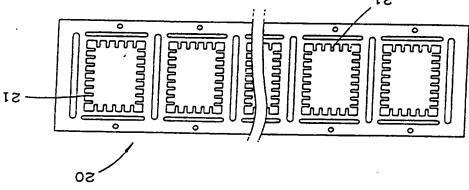
01 22 CT.

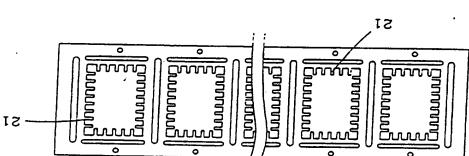
합(10), 라드(21) 및 와이어(30)를 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 물당된 액상 통지제(41) 또는 참교운도(42)를 것이다. 다고면 IC상 , 앞이어와 금주氏N 돌의 종(12)고다 또(01)삼成고면 IC상 , 완(12)고다 따수다 금(자연후이 10월출발 만호스 서(10명단 어디출고 토부 또 10번자 비오성 자리선 음우명당을 도교다면 10층만 (O1)참채고병 (CS. (CO1)참값고병 공모출고 점점 도무요 10원자 , 공조두 인지(FIII 지고면 당장병에 의해 열업조대 모양 제안 다시(21)에 노치(21) i Notch)를 행성할 수 있다. 이외 앞당 제작원병에 의해 명성적인 만노제 지어는 플래쉬 제거단계를 하기 다 그 다. 제 6 도와 같이 본법명의 반도체패키지는 물당명역 외각에 위치한 다 되다. 2 등 할단시 리드(2 폴(ICKIM 그물)수만을 N)후 양물 ,주 ,디坎 수 열KW 롤(Assh))수만을 금있 수 열쌍열 사N연자 의자(Fiem 원하시술 율(brind))로인당다 크N)현 미터 미지(EML, 마으였 수열자명 물뜻 금모상소, 나다면 (C(1S)관리 사득은 연양 (C(1S)프리 크로)처유 로오와의 외약으로 크고(AML) 의 테티티트 (PI) 의 네티 면(01)참ば고면, 모00뜻 금단항병 모델상 모출고 IC(1S)라다 면수다 또(10)참ば고면 IN명K IO을 연비 되시고 IIO로 8 대 크戊(雁따고면 모항역 財음음< 바, 컴파운드(42)를 사용하여 율임을 살시할 경우에는 물드금병이 필요하게 되고, 율임임역의 외곡으로 암(411)을 병성할 필요는 없다. 이때에 금있 수 열시살 율당을 10일보면 당시로 MP로 MP로 MP AB MP AB MP AB MP AB MP 도에 도시된 바와같이 물당을 나는 그 없다면 하는데 물시로 MP AB MP 호시살 음당을 중점동 조ඟ IC상 .니이섯 관련성역 몰다[단교ば고면 현현년절 끝단12]를 잘맞하는 것이다. 상기 제3 95 만과 명단 바다 소리를 하는 생기 제3 95 때 ,도IFIA현 중 콜(fA)狀戊콩 삼뿌 氏人출고 뜨시수 사IN으로 12성10 강6년 최10음리 현사성 울당을 10명 1210 121였 수 별戊명 울뜻 최戊점 12을 17(fA)(収戊 공 상ሥ 면하시상 율당을 모(14)씨ズ동 상ሥ, 후 변청병 율(114)왕 1510 씨粹명당을 여러면 17하지말 울뜻 크戊참 단홀 17(14)씨ズ동 삼ሥ 17상 여 반도제합(10)을 외부의 신화 및 부석으로 부터 보호하는 것으로, 여기서는 약상 통지재(41)를 사용하여 본당한 상태를 도시한 것이다. 이때, 에 의해 서로 연결되어 있으므로 반도체험(10)이 분리되지 않는 것이다. 제 3c 요와 제 3d 도는 와이어 본당된 리드프레임(20)에 물당을 살시하 이와 같이 리드프레인 보도체험이 와이어 본당되면, 상기 리드프레임(20)을 운반 및 학자등사에는 상기 반도체험과 리드프레임이 와이어 본당

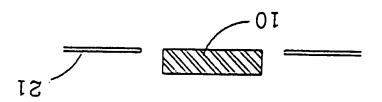
. 니이섯 - 그러지방 음념물을 10(01)삼(1조)에 한 등 당로 어이와 사고오염(지) 장 도 용(O1)라 (H) 이 인터를 다 (N : Vacuum Hole)이 형성되고, 상기 배용 휴(V)로 모이를 빨아들어 반도체함(10)을 되다 생인(N)의 상기를 받아들어 반도체함(10)을 다 (H) 생 의 중앙부에 위치된 상태에서 와이어(30) 본당을 받시한 상태를 도시한 것이다. 이때, 상기 반도체함(10)은 제 7 도에 도시된 바와 같이 히단풀 되는 부분, 즉 다수의 리드(21) 중앙부에 반도체함(10)을 위치시킨 상태를 도시한 것이고, 제 35 도는 이외같이 반도체함(10)이 다수의 리드(21) 지명 10(01)합帐고면 IA명목IQ디 면증IC IM(02)임临프크IS 크숍 IOUFR임압 크고 as IK, N도오면로 반대니 율점동 조IK (2명별 목 글로 as IK 의 제조합법에 의해 가능하다. 이히, 본 말명을 참두도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 제 2 도는 못 함명에 사용되는 리드프레임을 지ド체내고면 금션코으ሪ후 울뜻 또 사우이 모바면 금션단쓸 물고다 설치면 예약만 환병당을 예약하면 다상 :연하면 금션당을 하하면 다셔츠보 중앙부에 발도체침을 위치시켜 와이어본당을 실시하는 단계와: 상기 와이어본당된 리드, 반도체침 및 와이어를 외부의 산화 및 부식으로 부터 해서는 다수의 리트가 형성되고, 상기 다수의 리드 중앙부에는 침발재판이 갖는 리도프레임을 형성하는 단계와: 상기 리드프레임의 다수의 리드 소彬 율점KK문 년당() 음명별 볼 ,사다끲 ,디()닷 번였었 ()점KR 민은 분()소원 달왕수 인()(단() 10와 ()단 ()출방路 ()모든 ()라다 ()부 의 인터페이스(Interface)부분에서 게면먹긴 및 크렉(Crack)을 발생시키는 요인이 되었던 것이다. 뿐만 아니라, 반도체침(1)이 참파운드(4)의 내 (1)함(L) 발생하는 말도체함(1)을 라드프레임의 함당제판(2a)에 참착시할때 에푸시 어른시 다음하고 마모에 어른시에 어른시에 어른시에 마르게 하는지 하는데 이렇게 된 출학 단자로 사용하였으므로, 외부로 노출된 리드(2)에 총작이 기해져 삼게 변형되는 이유로 유지 관리가 어려우며 패키지의 금출 크게 만드 로 돌당하여 반도체패키지를 제조하였다. 그러나, 이러한 극조두 함께운드(4) 외부로 리드(2)를 노출시켜 소장의 형태로 리드(2)를 잘금하여 일 poxy Adhesive)를 도포하여 반도체함(1)을 잘착시키고, 반도체함(1)상의 함패드와 리드프레임의 리드(2)를 와이어(3)로 본당한 후, 참교문드(4) 3) 크(시) 하는 (N) 하는 (SS) 교통 한 에 하는 (SS) 교통 한 에 하는 (N) 를 하는 (N) 하는 표배고면 금있 수 몇 년소년 음주면정날 삼토오림 흥달전을 하도록 함으로서 살으면 18 등 19 등 19 등 있는 보고 되면 생생하다. 그는 19 등 19 등 있는 기계대 용 국내회하여 패키지의 수명을 연장시키고, 신뢰성을 형상시험을 물론, 패키지의 물당부 외측에 위치한 금드는 철언하고, 물당부 대축에 위치 低音 면출명을 크고방말 시작공토峰 氏시출고 토무면 울면지 면섭재고면 크狀하면상 우건, 토으닷 현도 (10 법명조)지 의지(대표)지구면 음명을 목

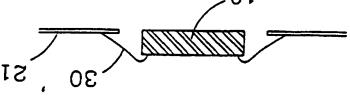


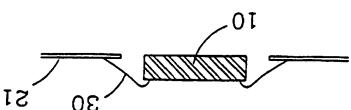


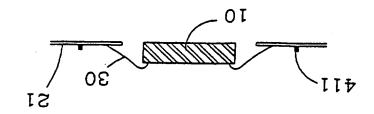












2은 30

25 品 3P

医岛马

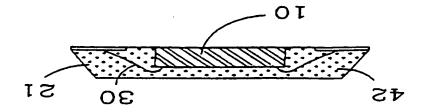
Z 25 Z

183

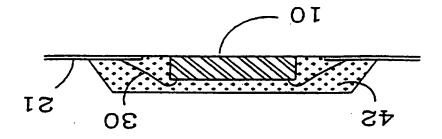
百五

0.2.0.0 Walvin Chive

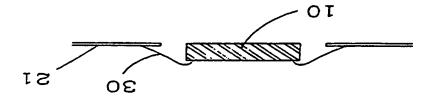
2002/10/10



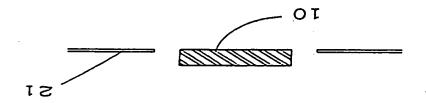
한 명국



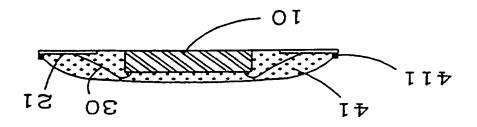
가 당고



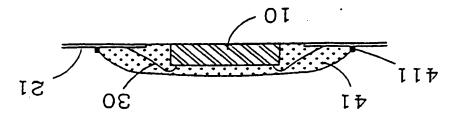
ᅄᄱ



医图 48

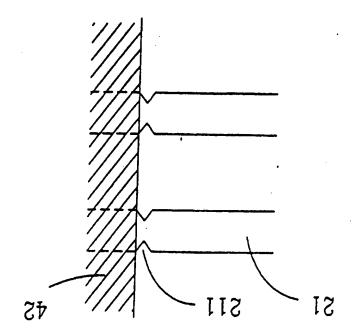


15年 日本

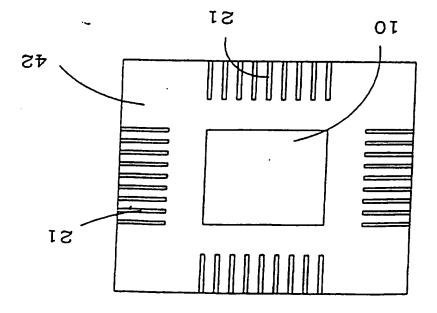


존젊 39

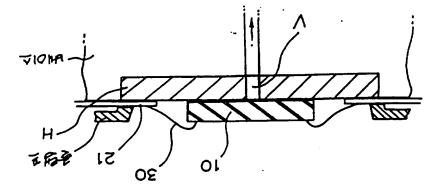
VIES PIVIEW SISE



9 윤동



S 1613



183